

公司代码：688249

公司简称：晶合集成

合肥晶合集成电路股份有限公司
2025 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	晶合集成	688249	不适用

公司存托凭证简况

☐适用 ☒不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	朱才伟	曹宗野
电话	0551-62637000转612688	0551-62637000转612688
办公地址	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号
电子信箱	stock@nexchip.com.cn	stock@nexchip.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	51,206,485,180.79	50,398,579,443.20	1.60
归属于上市公司股东的净资产	21,024,780,291.61	20,870,311,007.81	0.74
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	5,198,454,703.34	4,397,777,256.70	18.21
利润总额	232,046,990.31	194,858,870.41	19.08
归属于上市公司股东的净利润	332,128,758.87	187,002,537.88	77.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	203,831,533.70	94,674,882.94	115.30
经营活动产生的现金流量净额	1,705,034,907.06	1,295,165,395.36	31.65
加权平均净资产收 益率(%)	1.58	0.86	增加0.72个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.17	0.10	70.00
稀释每股收益(元/ 股)	0.17	0.10	70.00
研发投入占营业收 入的比例(%)	13.37	13.97	减少0.60个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）					62, 768		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	国有法人	23. 35	468, 474, 592	468, 474, 592	468, 474, 592	无	0
力晶创新投资控股股份有限公司	境外法人	19. 08	382, 732, 181	0	0	无	0
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	其他	16. 39	328, 736, 799	328, 736, 799	328, 736, 799	无	0
美的创新投资有限	境内非	2. 44	48, 922, 082	0	0	无	0

公司	国有法人						
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.21	44,406,262	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.66	33,228,810	0	0	无	0
北京集创北方科技股份有限公司	境内非国有法人	1.32	26,523,451	0	0	无	0
安徽创谷股权投资基金管理有限公司－合肥中安智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.97	19,545,003	0	0	无	0
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95	19,022,627	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.91	18,314,306	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥芯屏与合肥建投为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 ☐不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券 余额	利率 (%)
合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 (科创票据)	24 晶合集成 MTN001 (科创票据)	F102483400	2024-08-07	2029-08-09	8.00	1.90
合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	25 晶合集成 MTN001 (科创债)	F102582055	2025-05-12	2030-05-14	2.00	1.85
合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	25 晶合集成 MTN002 (科创债)	F102582892	2025-07-14	2030-07-15	10.00	1.71

反映发行人偿债能力的指标:

☒适用 ☐不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	48.95%	48.23%
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	8.60	7.07

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用